國立臺灣師範大學機電工程學系電子顯微鏡使用申請表

申請人姓名:日 申請日期:年月日 (請務必於使用前2日提出申請)
服務單位: 使用日期:年日
申請人簽章: 使用時間: 時分 (請務必依申請時間準時報到,違者依規定停權)
聯絡電話: 審核人簽章:
服務項目:□表面觀察 □照相 □EDS 分析 □其他
試片名稱: 材料種類:
狀態:□固體 □粉末
性質:□穩定 □揮發性 □磁性 □毒性
試片處理:□真空鍍金 □真空鍍碳 □脫水
備註及說明:

● 服務項目

- 一、(1)SEI(Scanning Electron Image),影像觀察,破斷面,金相表面觀察。
 - (2)BEI(Backscattered Electron Image): TOPO(Topography),表面觀察。COMPO(Composition),元素鑑別及分析。
- 二、「能量分析散光譜儀」(Energy Dispersive X-ray Spectrometer)可作微區成分之定性、半定量分析。

● 注意事項

- 一、試片取樣直徑最大不超過 25mm(最好在 10mm 以內為宜),最大高度 10mm,試件請自行前處理。
- 二、如為非金屬、高分子、粉體試片,請務必做固定及蒸鍍處理。若欲影像觀察,請先鍍金;若需定性、半定量分析,則選擇碳鍍膜。在電子束照射下會分解或釋出氣體之試片禁止使用。
- 三、本儀器拒絕受理含有毒性、腐蝕性、揮發性、磁性、水分及低熔點之試片。